

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC9265xxxx4R-G
標準質量: 4 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.466	シリコン	116600	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	1.220	ニッケル	305000	7440-02-0
	0.056	銀	14000	7440-22-4
	0.012	金	3000	7440-57-5
ダイアタッチ	0.025	エポキシ樹脂	6300	—
	0.021	酸化アルミニウム	5300	1344-28-1
	0.000	シリカ	100	—
ボンディングワイヤ	0.083	金	20700	7440-57-5
封止樹脂	1.852	熔融シリカ	463000	60676-86-0
	0.106	エポキシ樹脂	26400	—
	0.095	フェノール樹脂	23800	—
	0.063	金属水酸化物	15900	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。